

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证

券

## 厦门中构新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨培顺
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“厦门中构”或“公司”）及全资子公司厦门中构供应链管理有限公司（以下简称“中构供应链”）拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，其中公司额度为人民币2,000.00万元，中构供应链额度为人民币1,000.00万元。上述授信额度仅限于用于企业日常生产经营。以上归属于公司的授信额度以“一种基于人工智能的光优组件发电效率模拟装置与方法，专利号：ZL202410392246.1、一种抗折弯楼承板的加工设备及加工方法，专利号：ZL202111351754.8、一种全自动钢筋桁架楼承板生产线的控制系统，专利号：ZL202011239057.9”进行质押担保，并由关联公司厦门晟乾钢品科技有限公司无偿提供连带担保责任，归属于中构供应链的额度由公司和关联公司厦门晟乾钢品科技有限公司提供连带责任保证担保，公司实控人杨培顺及实控人配偶肖宝凤拟对全部额度追加保证担保，构成关联担保。以上授信额度最终以中国光大银行股份有限公司厦门分行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。详情见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

## 2.回避表决情况：

本事项为公司单方面受益的关联交易，免于回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日